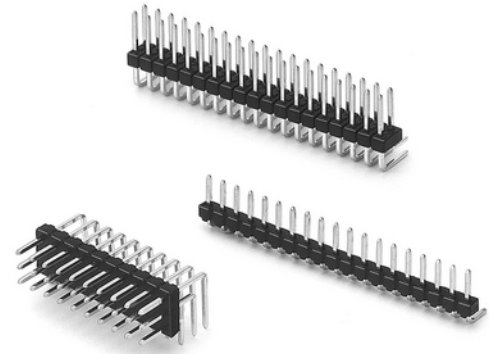


146 / 147 / 148

Stiftleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-/3-reihig
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, 1/2/3 Rows

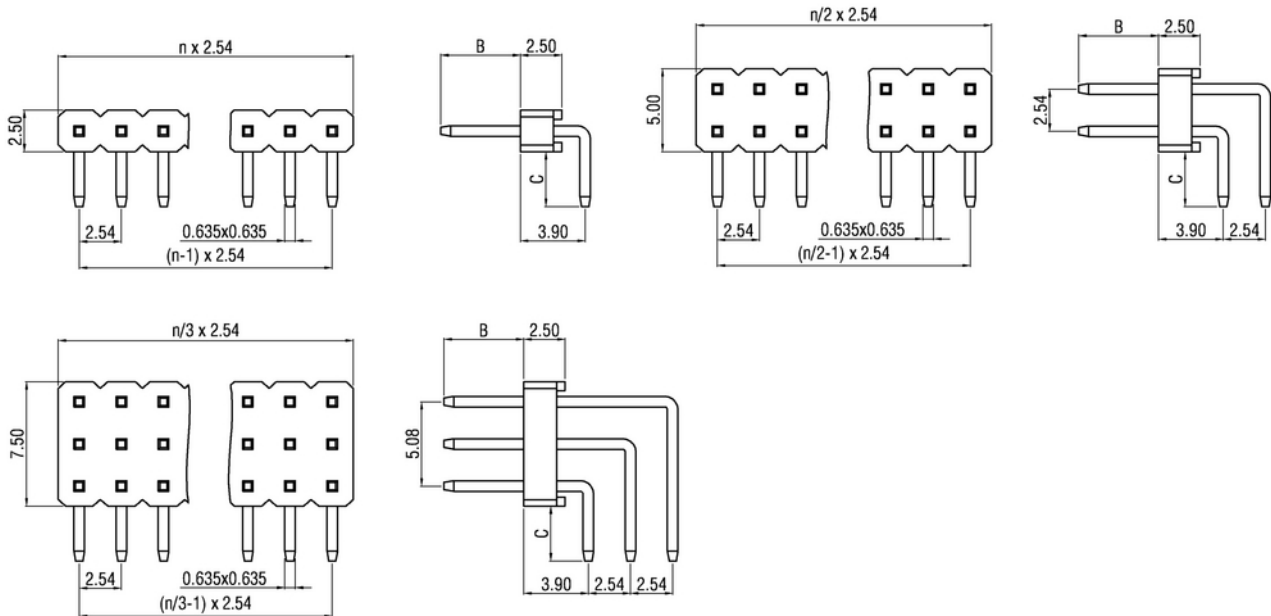
Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i> |
| Kontaktfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i> |
| Lötbarkeit <i>Solderability</i> | IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20mΩ <i>< 20mΩ</i> |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i> |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 1kV _{DC} <i>1kV_{DC}</i> |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | 250V _{AC} <i>250V_{AC}</i> |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 3A <i>3A</i> |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -55°C ... +125°C <i>-55°C ... +125°C</i> |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i> |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Mate with Female Headers:
153 154 340 348 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series*

146

Thermisch gerissene Kontakte
Electro-strictioned contacts
146 Einreihig
Single row
147 Zweireihig
Double row
148 Dreireihig
Triple row

Dimensions*

12

12 B=3,50 C=3,30mm
13 B=4,80 C=3,30mm
14 B=6,10 C=3,30mm
15 B=6,90 C=3,30mm
16 B=9,90 C=3,30mm
17 B=12,00 C=3,30mm
18 B=13,80 C=3,30mm
19 B=15,00 C=3,30mm
20 B=17,10 C=3,30mm

Contacts*

010

001-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row
009-150 Dreireihig
Triple row

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
10 0,25µm Gold
0.25µm gold plated
30 0,75µm Gold
0.75µm gold plated
50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au 0,25µm / Sn
80 Sel. Au 0,75µm / Sn

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.

We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more pin lengths and dimensions on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-20

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

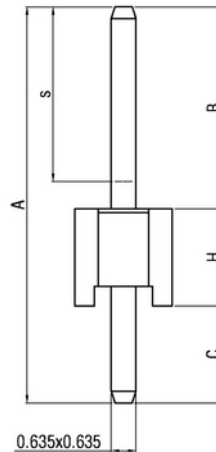
Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

Dimensions and PCB Layouts

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

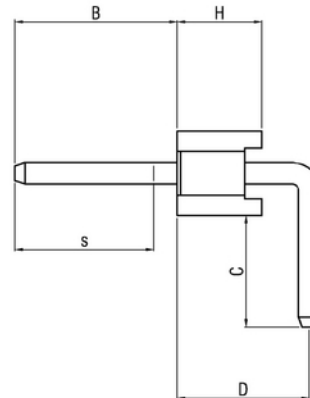
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



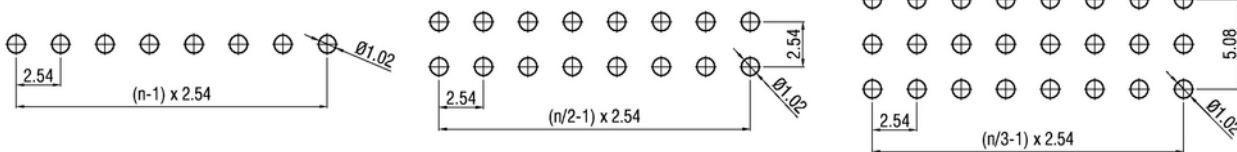
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



PCB Layouts



Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

